

## 株主メモ

事業年度 毎年1月1日から12月31日まで  
 定時株主総会 毎年3月  
 基準日  
 期末配当金 毎年12月31日  
 中間配当金 毎年6月30日  
 その他必要ある場合は、取締役会の決議により、あらかじめ公告いたします。

株主名簿管理人  
 特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社  
 (連絡先) 東京都府中市日鋼町1-1  
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
 電話 0120-232-711 (通話料無料)  
 (郵送先) 〒137-8081  
 新東京郵便局私書箱第29号  
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

単元株式数 100株  
 公告の方法 電子公告により行いますが、事故その他やむを得ない事由によりできない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。  
 (公告掲載URL)  
[https://www.tok.co.jp/company/public\\_notice.html](https://www.tok.co.jp/company/public_notice.html)

上場取引所 東京証券取引所 プライム市場  
 証券コード 4186

## ご注意

- 住所変更、単元未満株式(100株未満の株式)の買取請求その他各種お手続きにつきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、左記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店においてもお取り扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、当社定款の規定により、支払開始日より満3年を経過いたしますとお受け取りいただけませんので、お早めに最寄りの三菱UFJ信託銀行本支店でお受け取りください。

## 株式に関するお手続きについて

お手続き、ご照会等の内容	お問い合わせ先	
	証券会社等の口座に記録された株式	特別口座に記録された株式
<ul style="list-style-type: none"> <li>■単元未満株式の買取・買増請求</li> <li>■住所・氏名等のご変更</li> <li>■配当金の受領方法の指定(注)</li> <li>■マイナンバーに関するお届け・ご照会</li> </ul>	口座を開設されている証券会社等	左記の特別口座の口座管理機関
<ul style="list-style-type: none"> <li>■特別口座から一般口座への振替請求</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■支払期間経過後の配当金に関するご照会</li> <li>■郵送物等の発送と返戻に関するご照会</li> <li>■株式事務に関する一般的なお問い合わせ</li> </ul>	左記の株主名簿管理人	

(注) 特別口座に記録された株式をご所有の株主様は、配当金の受領方法として「株式数比例配分方式」はお選びいただけません。



IRメール配信を行っています。ぜひご登録ください。

<https://rims.tr.mufig.jp/?sn=4186> ▶▶▶

## プロバスケットボールクラブ「川崎ブレイブサンダース」とオフィシャルスポンサー契約を締結

経営ビジョン「豊かな未来、社会の期待に化学で応える“The e-Material Global Company™”」を掲げる当社は、川崎ブレイブサンダースを応援することを通じて、当社が80年以上事業を営んできた川崎のより一層の発展に貢献するとともに、川崎を起点としたスポーツの振興を後押しし、豊かな社会の実現を目指していきます。



**KAWASAKI  
BRAVE THUNDERS** ©KBT

**tok 東京応化工業株式会社**

〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地  
 電話 044-435-3000 (代表)



ユニバーサルデザイン(UD)の考えに基づいた見やすいデザイン  
 の文字を採用しています。

豊かな未来、社会の期待に化学で応える  
 “The e-Material Global Company™”

**tok 東京応化工業株式会社**

## 第94期 報告書

2023年1月1日～2023年12月31日

0.000000001mから、  
 技術は深化する。



## 2030年に向けた 戦略的投資を加速させていく

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社グループの第94期の業績および今後の取り組みにつきましてご報告申し上げます。

代表取締役 取締役社長 **種市順昭**



### Q1 第94期における市場環境および業績について教えてください。

当期のエレクトロニクス市場は、スマートフォンやパソコンの需要低迷により、半導体需要は前年を下回って推移しました。

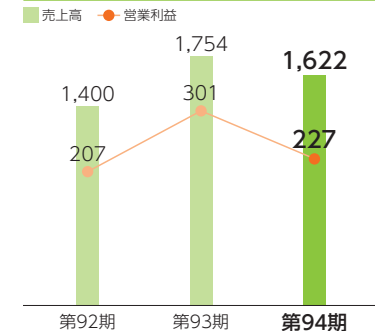
このような情勢下において当社グループは、「tok中期計画2024」で掲げた目標を達成すべく、最先端の研究設備を積極的に活用し、顧客ニーズに応えることで先端レジストのグローバルシェア向上を図るとともに、ベンチャー企業との協業・支援や産学連携を強化し、オープンイノベーションによる事業協創に注力することで、電子材料および新規分野でのコア技術の獲得/創出に向けた活動を推進しました。また、将来の半導体需要増加を見据えた新工場の建設開始や増産対応投資の決定に加え、高純度化学薬品のサプライチェーンの最適化を進めるなど、高品質製品の安定供給と最適な生産体制の構築にも努めました。さら

に材料事業のさらなる事業成長を図るために、装置事業（一部を除く）をAlメカテック株式会社へ譲渡し、同社との協業を通じた新たなM&E (Materials & Equipment) 戦略を推進しました。そして従業員エンゲージメント向上に向けた各種施策の実施など、人を活かす経営にも取り組んだほか、より透明性の高い経営の実現と意思決定のさらなる迅速化を目的として、監査等委員会設置会社へ移行しました。加えて急激に変化する経営環境に対応すべく、経営基盤強化に向けてリスク管理体制の強化やDX\*環境の整備などの諸施策を講じてまいりました。

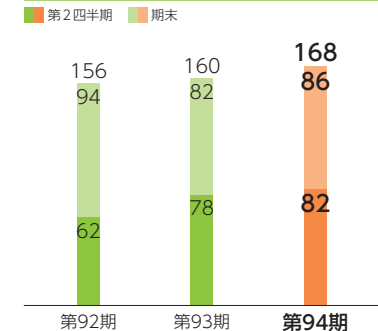
この結果、当期の売上高は1,622億円となりました。利益面では、円安に推移した為替の効果があったものの、売上減少に加え、将来を見据えた投資などを取付したことによる経費増加により、営業利益は227億円となりました。厳しい事業環境下でも、売上高、営業利益ともに過去最高に次ぐ実績を残すことができました。

\* デジタルトランスフォーメーション

売上高/営業利益 (単位:億円)



配当金の推移 (単位:円)



※ 当社は、2024年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。第94期以前は当該株式分割前の配当金を記載しております。

業績予想(通期) (単位:億円)

	第95期(予想)	増減率
売上高	1,792	10.4%増
営業利益	268	18.0%増
経常利益	277	14.2%増
親会社株主に帰属する当期純利益	176	38.4%増

### Q2 配当金については、いかがですか？

当期末の配当金については、DOE(連結純資産配当率)4.0%を目途とする配当方針に基づき、当初予想から4円増配し86円としました。これにより年間配当金は、第2四半期末配当金82円と合わせ1株につき168円となり、6期連続の増配となりました。

### Q3 第95期の見通しについて教えてください。

「tok中期計画2024」の最終年度となる今期は、昨年から続く半導体の生産調整の影響や季節性の要因により上期は前年度の下期と同水準で推移するものの、下期は当社製品のシェア向上と半導体市況の回復に伴う相乗効果が期待されることに加えて、生成AI向けなどで先端材料が引き続き好調に推移するものと考えられます。これらを背

景にエレクトロニクス機能材料や高純度化学薬品の販売が増加すると予想され、今期の売上高は過去最高の1,792億円を計画しております。また、営業利益についても、将来の需要を見越した投資の取付による減価償却費や人件費の増加に加え、グローバルサプライチェーンの構築に伴うコスト構造の変化による経費増加が見込まれるものの、エレクトロニクス機能材料を中心とした高付加価値製品の売上増加によって、過去最高に次ぐ268億円を計画しております。そして今期は、今年見直した2030年のありたい姿である「TOK Vision 2030」\*の実現に向けて、日本や韓国を中心に戦略的投資を加速させてまいります。

\* 「TOK Vision 2030」の見直しについては、次頁で紹介しています。

今後も、株主の皆様のご期待に応えられるようグループ一丸となって邁進してまいりますので、株主の皆様におかれましては、より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

▶ 当社のウェブサイトにて2023年12月期決算説明会の模様をご覧ください。  
▶ 当社ウェブサイト ▶ 株主・投資家情報 ▶ IRライブラリ <https://www.tok.co.jp/ir/library/2023>



# 「TOK Vision 2030」 「ありたい姿」の見直しについて

2020年に発表した「TOK Vision 2030」の見直しを今年2月に公表しました。定性側面に大きな変更はありませんが、定量側面は近年の市場環境の変化を踏まえて大幅に引き上げました。

## 見直し後の姿

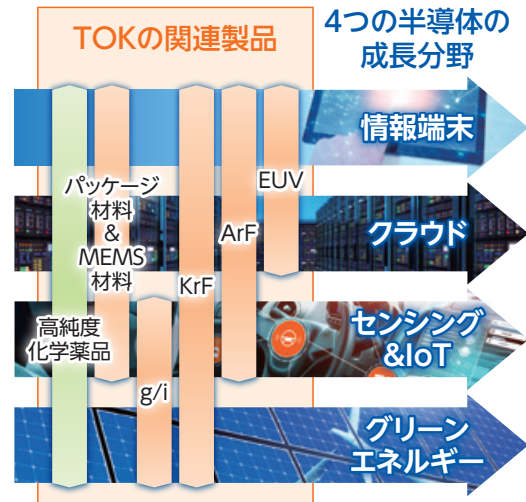
### 定性側面

- 顧客が感動するイノベーションを提供する
- 世界のステークホルダーから信頼される
- 高い技術力を育成し続け、グローバルで存在感を示す
- SDGsに貢献することを意識し、企業価値を持続的に向上できる
- 皆が活き活きと誇りをもって働ける

### 定量側面

	2020年度	2030年度	
		(見直し前)	(見直し後)
売上高	1,175億円	2,000億円	<b>3,500億円</b>
EBITDA	223億円	450億円	<b>770億円</b>
ROE	6.7%	10%以上	<b>13%</b>

## 見直しの背景



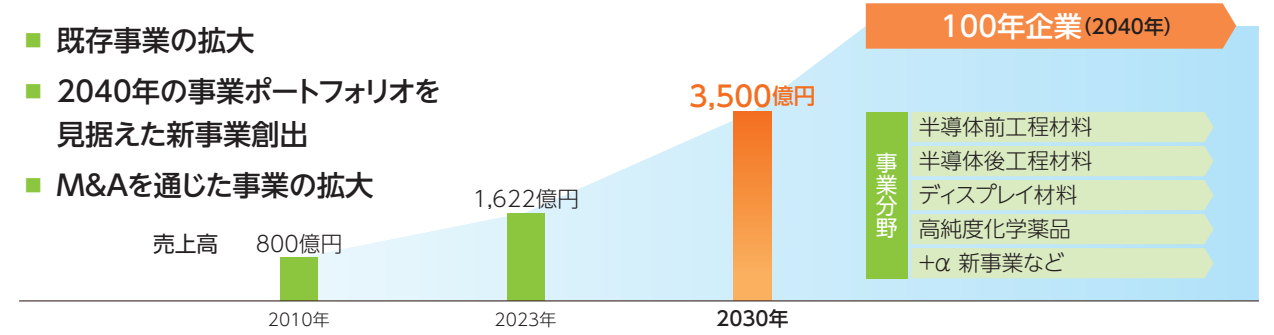
## デジタル技術の急速な発達と新たな展望



「デジタル技術の急速な発達と新たな展望」にあるように2030年に想定される社会ニーズは、当初想定していた社会ニーズよりも大幅に拡大していくものと考えられます。社会環境の変化の中心は半導体に支えられるデジタル技術であり、この急速な発展に伴って新たな可能性が広がっています。デジタル技術が描く、豊かな未来の実現に必要な不可欠なのが当社製品であり、「4つの半導体の成長分野」に貢献していくことでさらなる成長を目指してまいります。

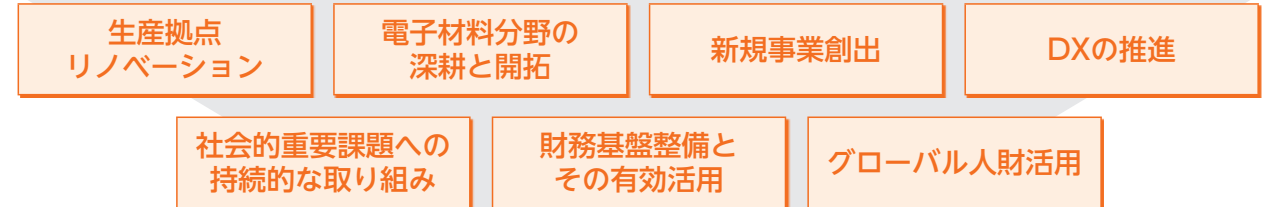
## 2030年のビジネス構成と成長イメージ

- 既存事業の拡大
- 2040年の事業ポートフォリオを見据えた新事業創出
- M&Aを通じた事業の拡大



## 経営ビジョンの実現に向けた7つの戦略

当社は「社会の期待に化学で応える」をパーパスに掲げ、社会の発展に貢献していきます。その上で、経営ビジョンである「豊かな未来、社会の期待に化学で応える“The e-Material Global Company™”」の実現のために、2030年に向けて7つの戦略を推進してまいります。



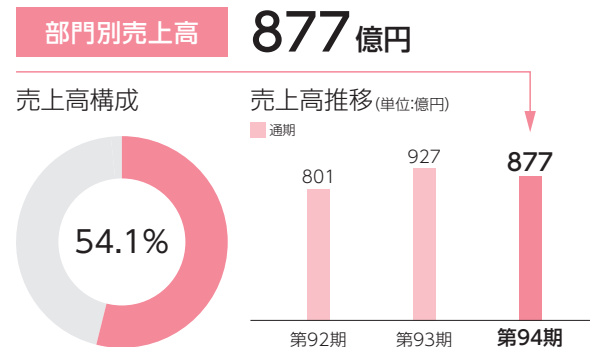
豊かな未来、社会の期待に化学で応える  
**“The e-Material Global Company™”**

# 部門別営業の概況



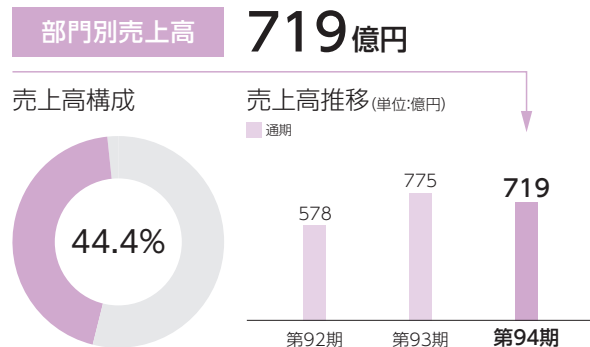
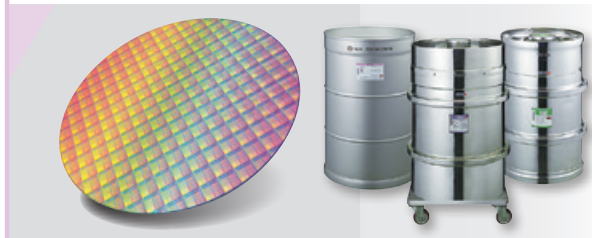
売上高は、エレクトロニクス機能材料部門が前年に比べ49億円減収の877億円（前年度比5.4%減）、高純度化学薬品部門も前年に比べ55億円減収の719億円（同7.2%減）となりました。これは、スマートフォンやパソコンの需要が前年度を下回る水準となり、半導体メーカーによる在庫調整等が続いたことが主な要因です。

## エレクトロニクス機能材料



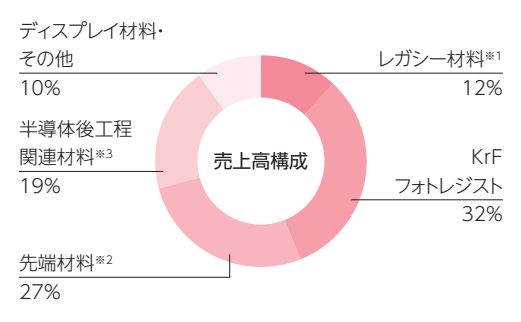
※ 第92期および第93期の売上高の金額については、セグメント開示の変更を避けて適用した後の金額を記載しております。

## 高純度化学薬品



## エレクトロニクス機能材料の種類別売上高構成

ArFフォトレジスト、KrFフォトレジスト、レガシー材料の売上高は、半導体減産の影響を受けたことで、前年度を下回りました。一方でEUVフォトレジストの売上高は、アジア地域や北米での使用量増加により前年度を大幅に上回りました。半導体後工程関連材料の売上高は、WHS関連材料が伸びましたが、パッケージ材料とMEMS材料が前年度を下回ったことで、前年度をわずかに下回りました。この結果、先端材料や半導体後工程関連材料の構成比率が増加し、エレクトロニクス機能材料における各製品の構成比は右の円グラフのようになりました。



※1 g線・i線フォトレジスト等 ※2 ArF・EUVフォトレジスト等 ※3 パッケージ材料、MEMS材料、WHS関連材料

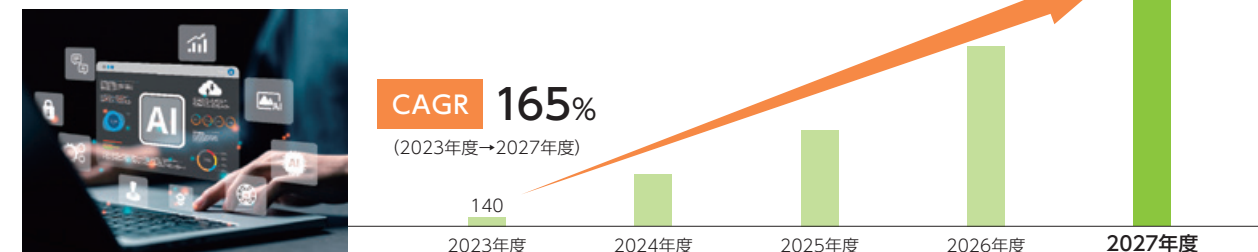
# コラム

## 生成AI市場の拡大とともに広がる事業機会

4年ぶりのマイナス成長となった昨年の世界の半導体市場は、今年には反転し、再び過去最大規模となることが予想されています。そうした中、注目されているのが生成AI市場の拡大に伴うGPUやHBM需要の高まりです。

当社グループは、HBMの製造に用いられるDRAMを積層するためのパッケージ材料に加え、DRAM製造向けのEUV/ArF/KrF用フォトレジストなどの供給を拡大していくことで事業機会を拓いてまいります。

### 生成AI市場の成長予測 (単位:億円)



出典: (株) シードプランニング「対話型AIサービスの現状と将来展望」(CAGRは当社計算)

### 生成AIに欠かせない半導体デバイス

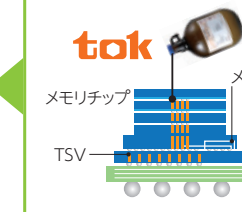
#### GPU (Graphics Processing Unit)



- 自ら答えを探し学習する「ディープラーニング」と「ニューラルネットワーク」を担う
- HBMにより、大量のデータを高速で並列処理

### GPUに欠かせない高速メモリーデバイス

#### HBM (High Bandwidth Memory)



- DRAMを縦方向に積層化
- 大量のデータを高速で処理し、スーパーコンピュータにも適用

**tok**  
生成AI向け材料の開発で優位性を構築

### 半導体製造・前工程



EUV/ArF/KrF用フォトレジスト

### 半導体製造・後工程

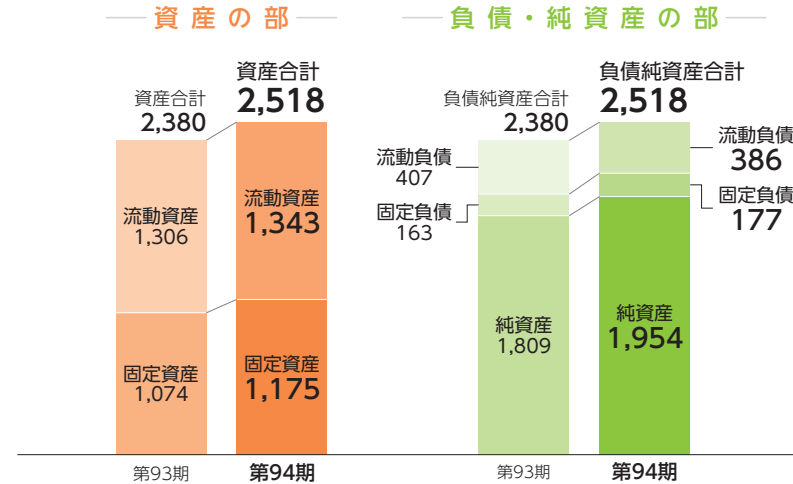


パッケージ材料



## 連結貸借対照表の概要

(単位:億円)



### 資産の部

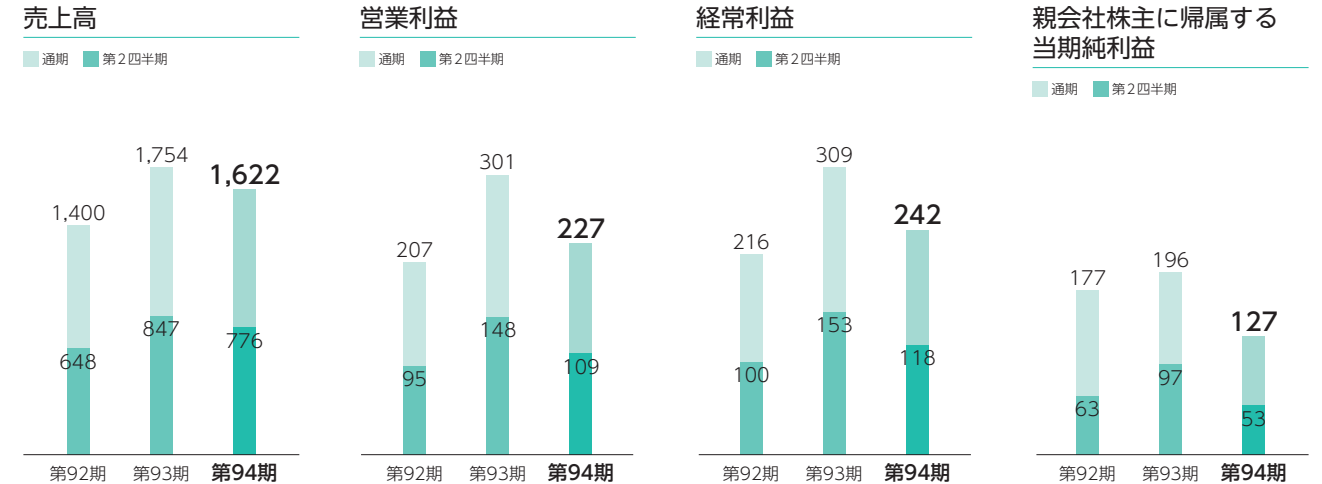
- ・棚卸資産が増加したことにより、流動資産が増加。
- ・設備投資によって有形固定資産が増加したことにより、固定資産が増加。

### 負債・純資産の部

- ・未払法人税等と支払手形及び買掛金が減少したことにより、流動負債が減少。
- ・利益剰余金とその他の有価証券評価差額金が増加したことにより、純資産が増加。

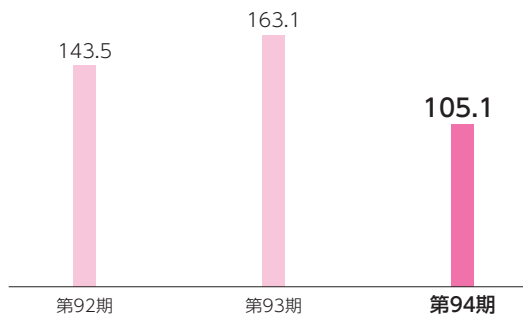
## 連結損益計算書の概要

(単位:億円)



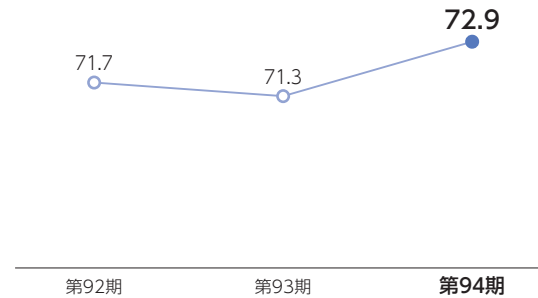
### 1株当たり当期純利益

(単位:円)



### 自己資本比率

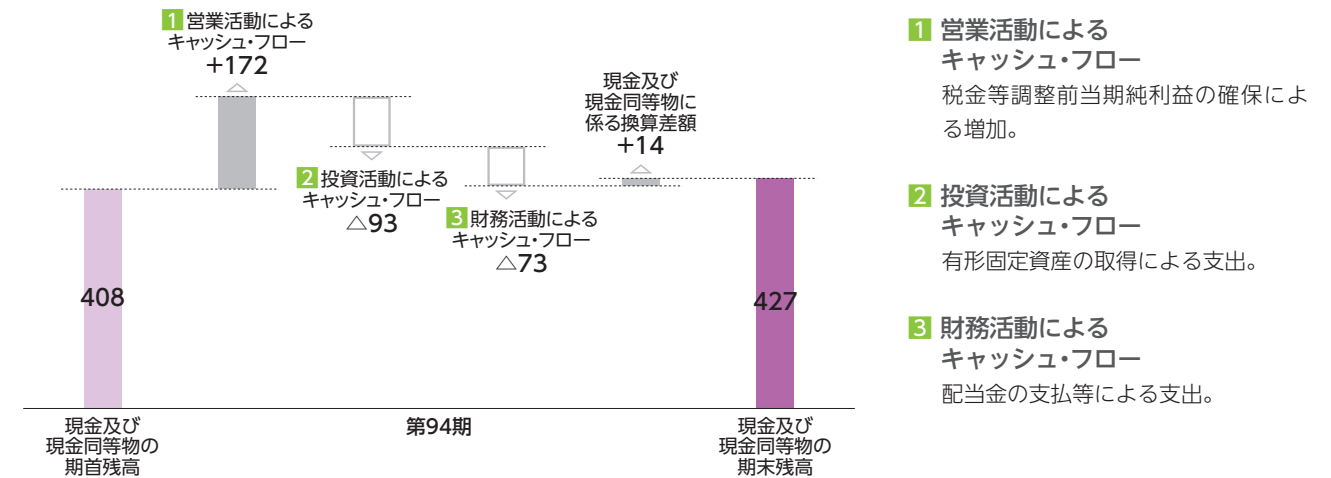
(単位:%)



※ 当社は、2024年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。第92期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。

## 連結キャッシュ・フローの概要

(単位:億円)



- 1 営業活動によるキャッシュ・フロー**  
税金等調整前当期純利益の確保による増加。
- 2 投資活動によるキャッシュ・フロー**  
有形固定資産の取得による支出。
- 3 財務活動によるキャッシュ・フロー**  
配当金の支払等による支出。

## imecとの協業20周年式典を開催

当社は、最先端半導体技術の国際研究機関imecのCEOであるLuc Van den hove氏をお招きして協業20周年式典を開催しました。EUV用フォトレジストをはじめとする先端材料や、次世代材料の開発を加速させていくにはimecとの協業の重要性がますます高まっています。当社は、imecとのさらなる関係強化を図り、微細加工技術を極め続けることで半導体の進化に寄与し、最終製品を通じて社会の期待に応えてまいります。



## 韓国子会社における工場用地取得

当社は、連結子会社であるTOK先端材料株式会社において、新工場建設のため工場用地を新たに取得することを決定しました。当地に建設予定の工場で自動化、省人化によるスマートファクトリー化を推進し、既存の仁川工場（仁川広域市）との相乗効果の最大化を図り、将来的な事業拡大に備えてまいります。なお、2027年着工、2028年からの操業を予定していますが、現時点で具体的な操業規模などは未定です。



京畿道の金知事との投資協約の調印式

### 取得用地概要

1. 所在地：韓国京畿道平澤市
2. 面積：55,560㎡
3. 価格：約31億円

## 東京応化グローバル社員持株会制度を導入

当社グループの海外売上比率は80%前後で推移しており、グローバル拠点の重要性は年々高まっています。そうした中で、当社はグローバル拠点に在籍する従業員に当社株式への興味をもっていただくことで、

自社株を意識し、勤労意欲および経営参画意識を高め、当社グループの中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、先進的な制度である東京応化グローバル社員持株会制度を導入しました。

(2023年12月31日現在)

## 株式の状況

発行可能株式総数	197,000,000株*
発行済株式の総数	42,600,000株*
	(自己株式2,140,134株を含む)
株主数	11,770名

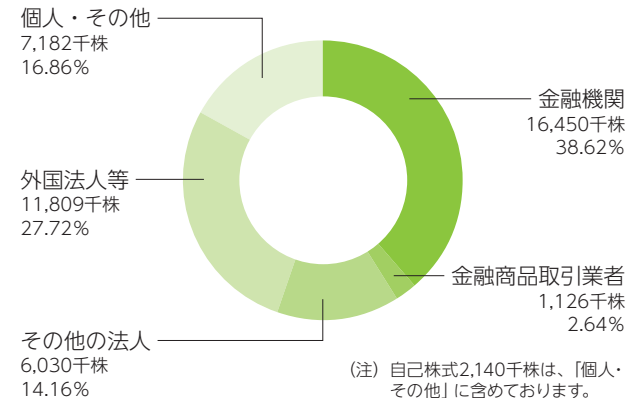
\* 当社は、2024年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行いました。これにより発行済株式の総数は127,800,000株となりました。また、当該株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2024年1月1日付で当社定款第6条に定める発行可能株式総数を500,000,000株に変更しました。

## 大株主(上位10名)

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	5,656	13.98
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	2,717	6.72
明治安田生命保険相互会社	1,826	4.51
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC	1,528	3.78
株式会社三菱UFJ銀行	1,207	2.98
株式会社横浜銀行	1,026	2.54
公益財団法人東京応化科学技術振興財団	984	2.43
三菱UFJ信託銀行株式会社	953	2.36
三菱UFJキャピタル株式会社	860	2.13
東京海上日動火災保険株式会社	857	2.12

(注) 1 当社は、自己株式を2,140千株保有しておりますが、上記大株主から除いております。  
2 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を除いた株式数(40,459,866株)を基準に算出しております。

## 所有者別株式分布状況



## 会社概要

社名	東京応化工業株式会社 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.
設立	1940年10月25日
資本金	14,640,448,000円
従業員数	1,877名(連結) (当社グループから当社グループ外への出向者および嘱託者を除く)
本社所在地	〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸150番地 電話044(435)3000(代表)

## 役員 (2024年3月28日現在)

### 取締役

役職	氏名
代表取締役社長	昭 俊
取締役	種 市
取締役	佐 藤
取締役	鳴 海
取締役	土 山
取締役	池 田
取締役	徳 竹
取締役	関 口
取締役	一 柳
取締役	安 藤

### 執行役員

※ 執行役員社長	種 市
※ 専務執行役員	順 宏
※ 常務執行役員	基 裕
※ 執行役員	鳴 海
※ 執行役員	山 瀬
執行役員	高 大
執行役員	本 間
執行役員	磯 貝
執行役員	人 財
執行役員	本 川
執行役員	渡 邊
執行役員	塩 谷
執行役員	澤 野
執行役員	大 野
執行役員	辰 野

(注) ※印を付した執行役員は、取締役を兼務しています。